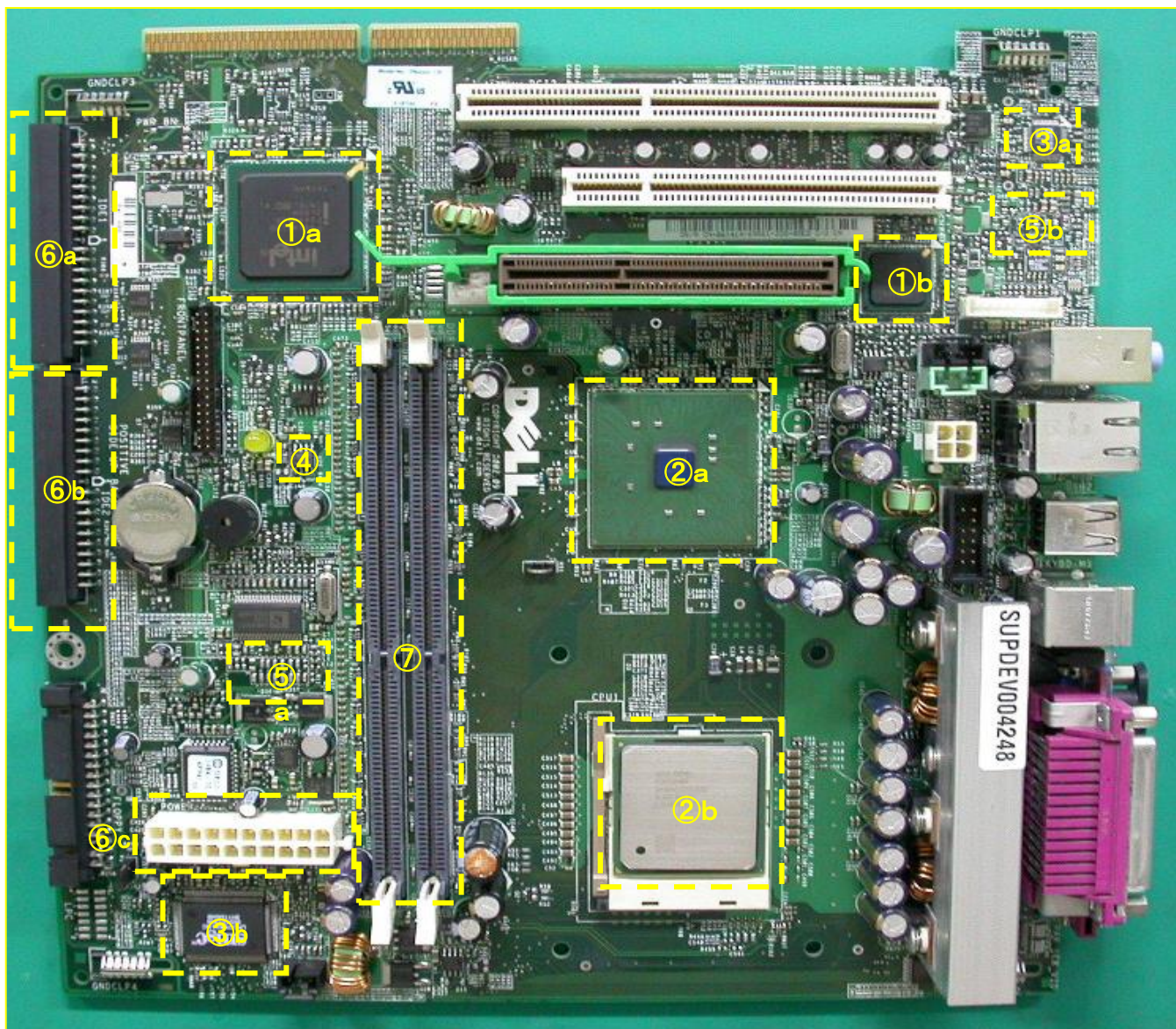


実装部品(電子部品～コネクタまで)の断面研磨を実施することが可能です。



【サンプル概要】

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ① BGA(断面)・実装状態(2次実装部) | ② FCBGA(断面)・実装状態(インナーバンプ) |
| ③a QFP(断面:ワイヤー)・Bd状態 | ③b QFP(断面:リード)・実装状態 |
| ④ SOP(断面)・実装状態 | ⑤ チップ部品(断面)・実装状態 |
| ⑥a コネクタ(平面)・勘合状態 | ⑥b コネクタ(断面)・基板実装・挿入状態 |
| ⑥c コネクタ(断面)・勘合状態 | ⑦ コネクタ(断面)・最長断面 |

内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

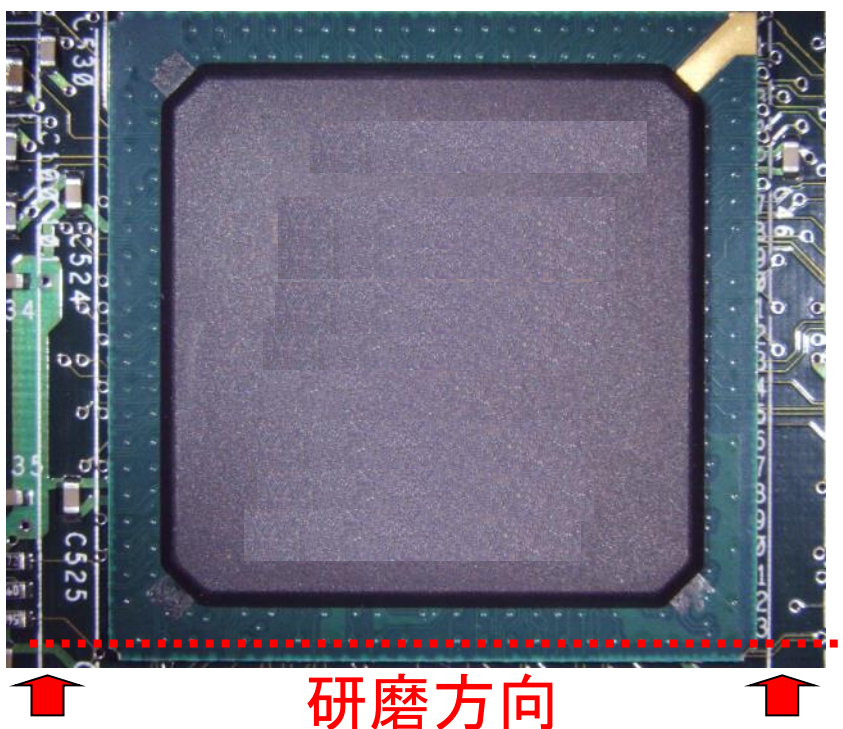
213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496

FAX: 044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>

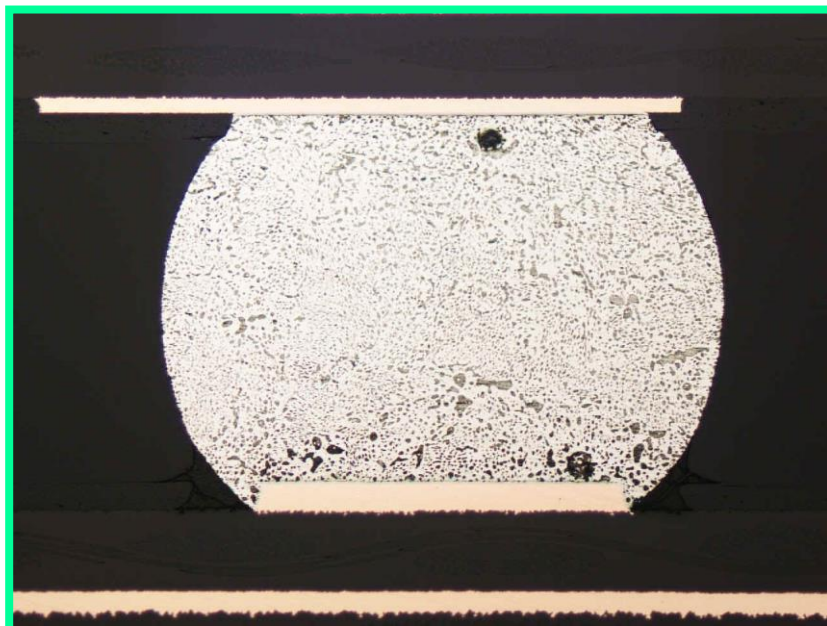
①a BGA(断面：最外周アウトボール)



研磨方向

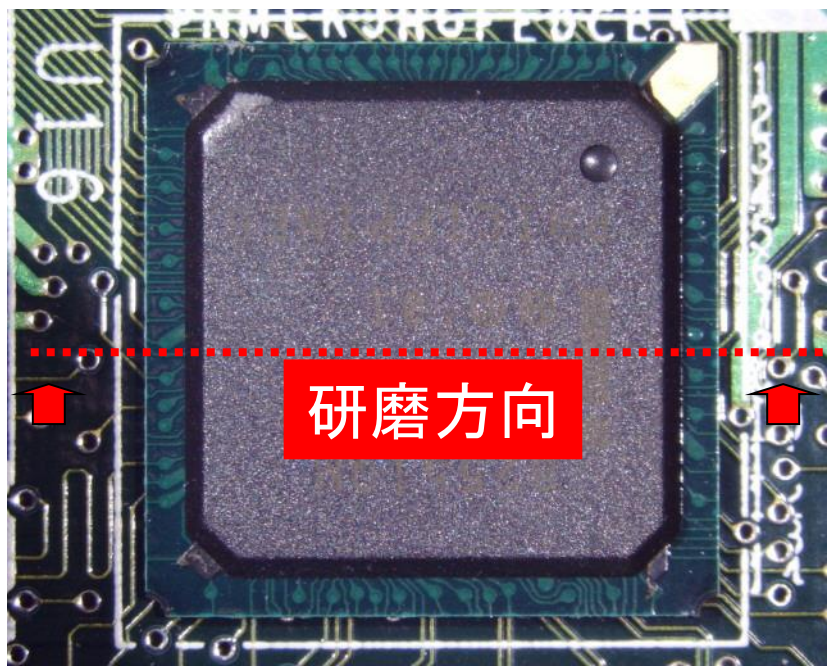


断面 全景写真

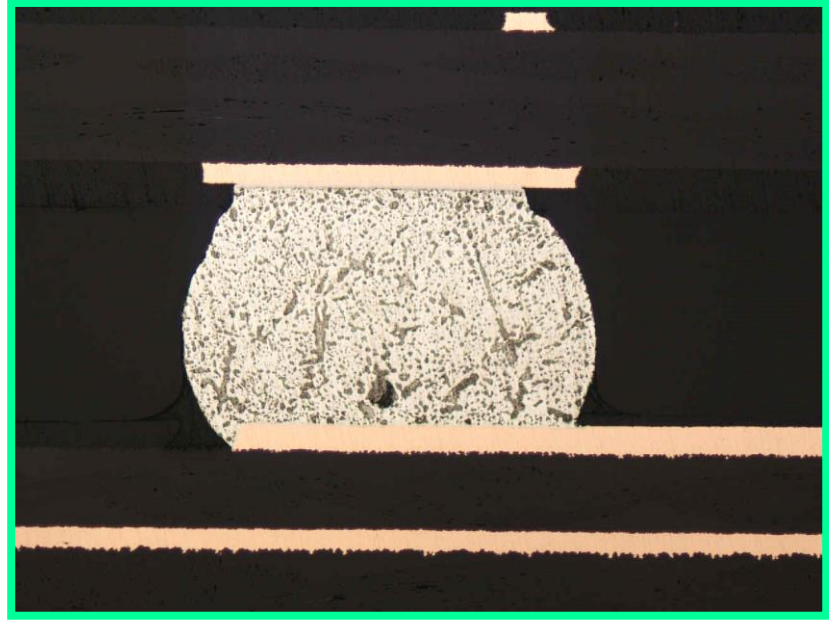


右端アウトボール 拡大

①b BGA(断面:アウトボール中央列)

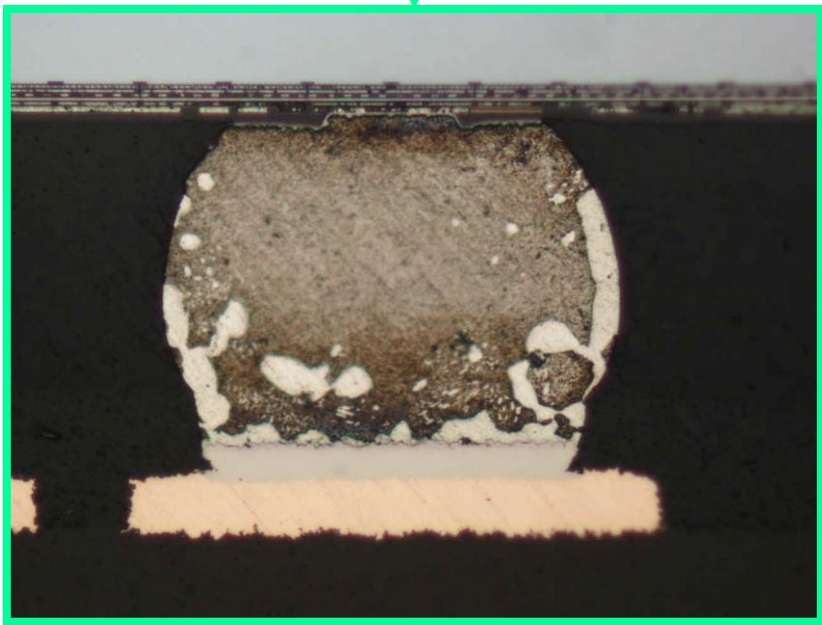
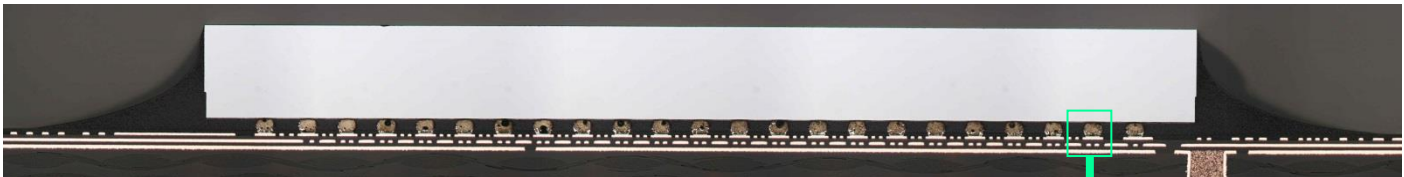
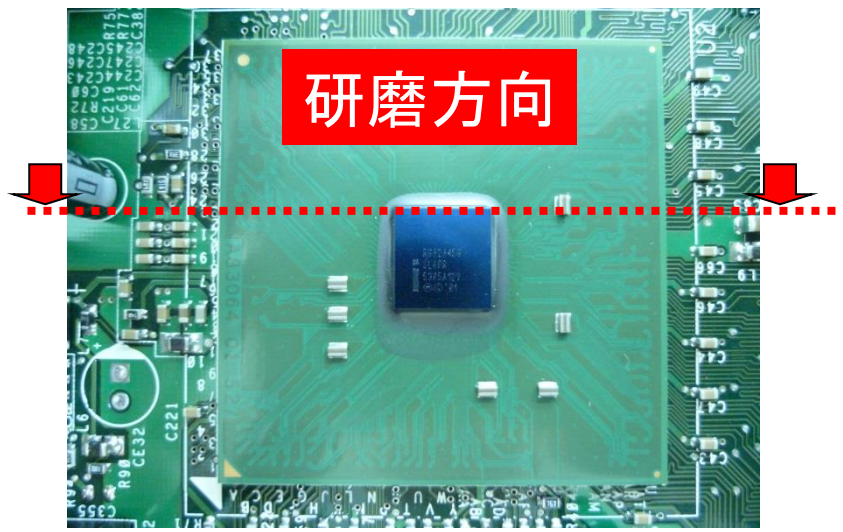


断面 全景写真

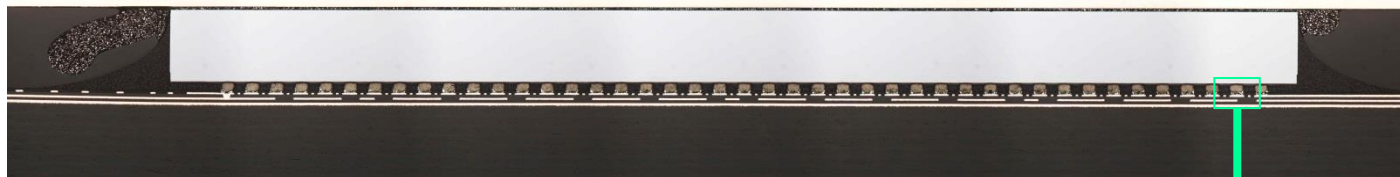


右端アウトターボール 拡大

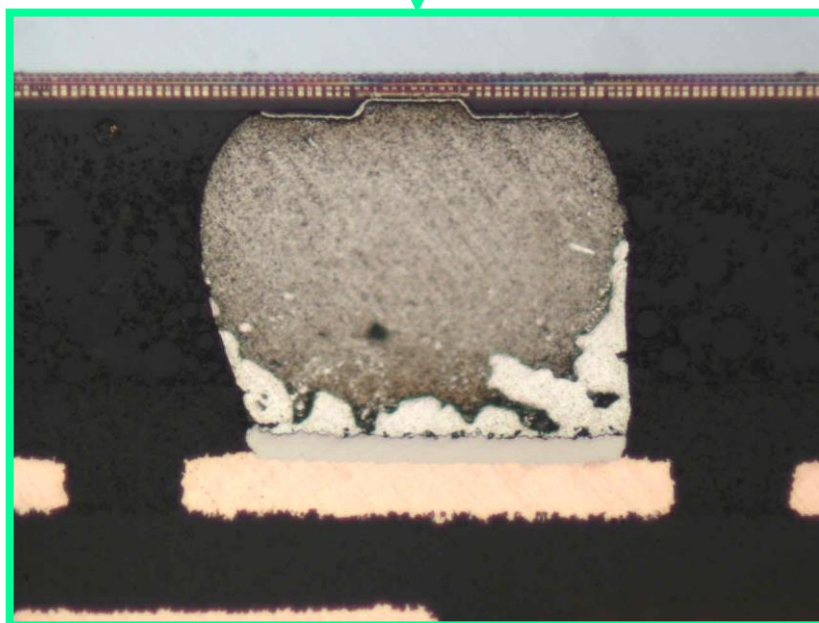
②a FCBGA(断面:最外周インナーバンプ)



②b FCBGA(断面：最外周インナーバンプ)

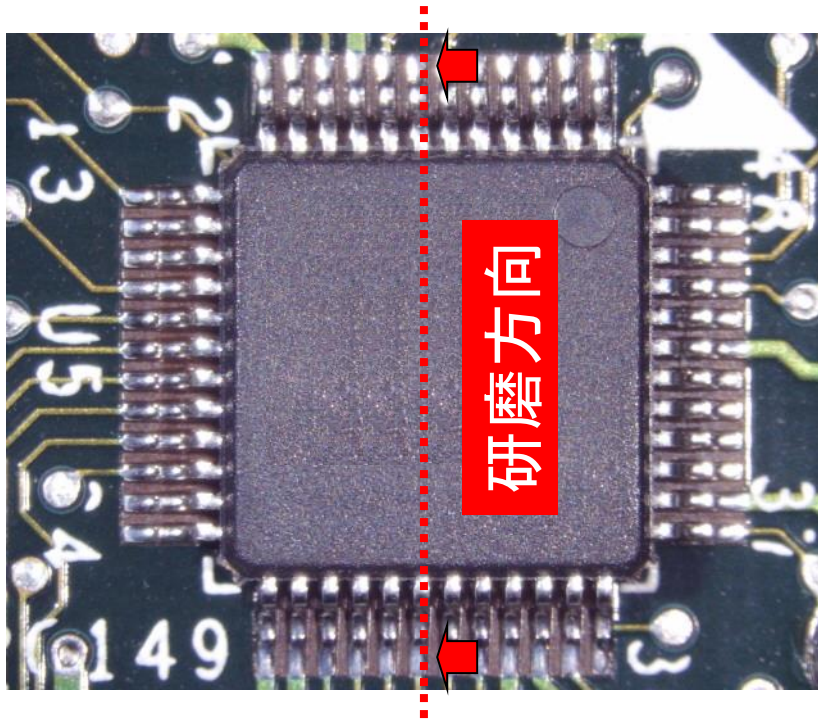


断面 全景写真

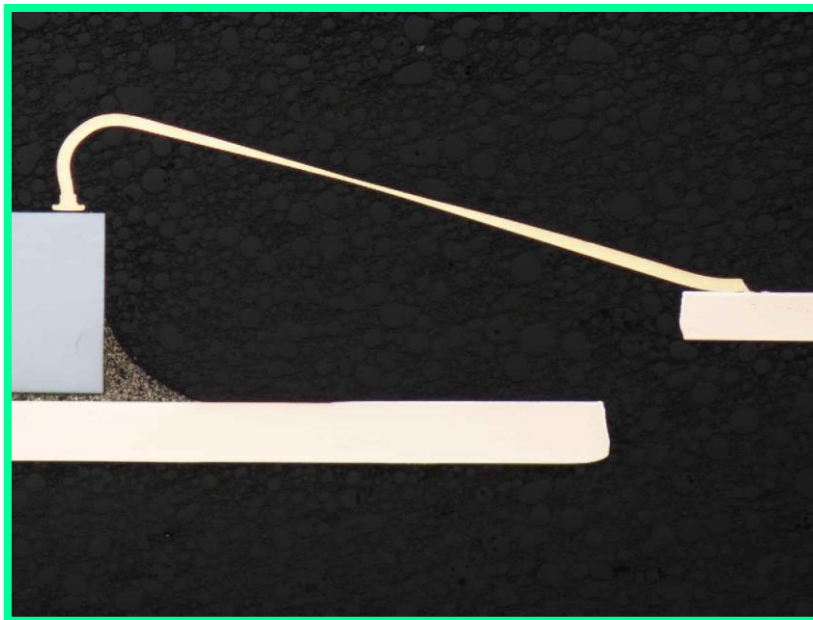


インナーバンプ 拡大

③a QFP(断面:ワイヤー)

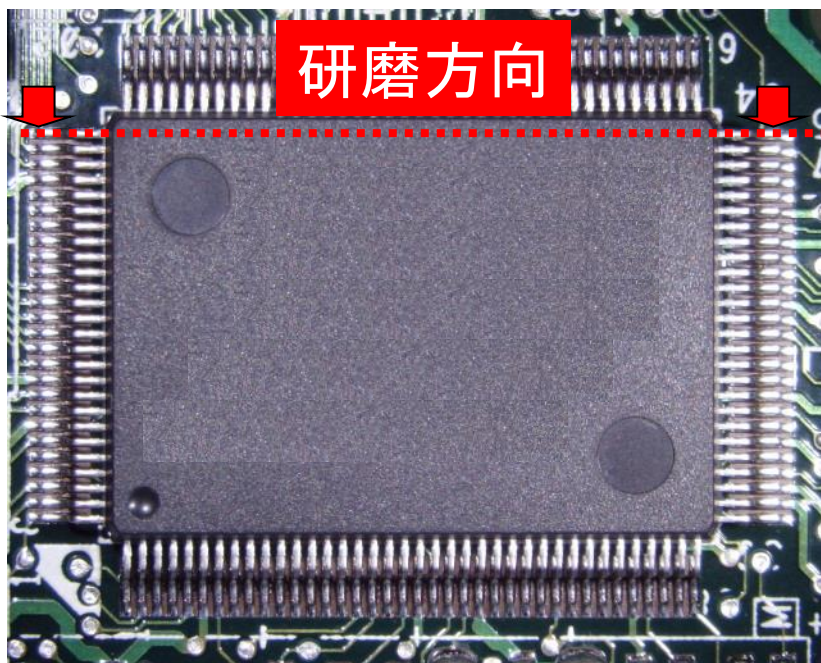


断面 全景写真



Bdワイヤー 拡大

③b QFP(断面:リード)

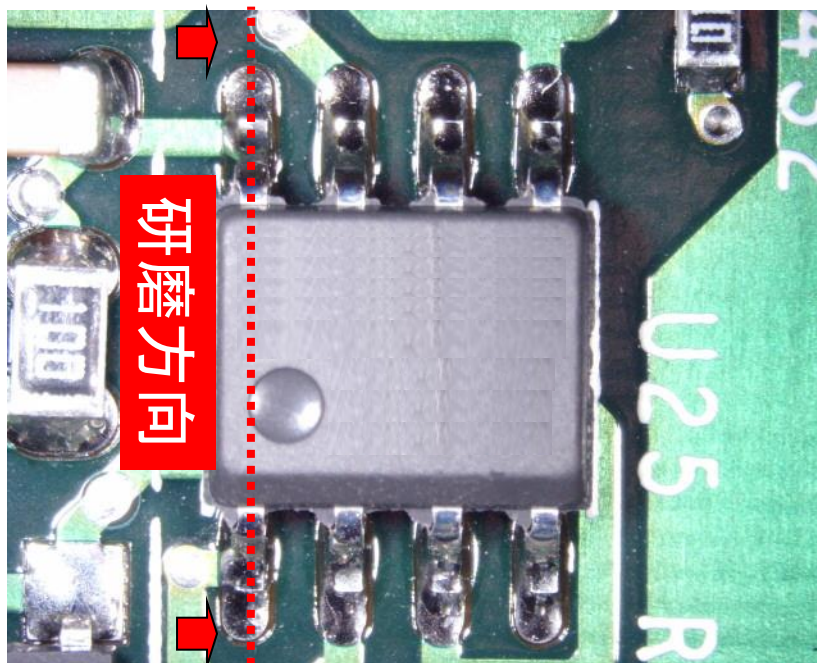


断面 全景写真



右側アウターリード 拡大

④ SOP(断面)

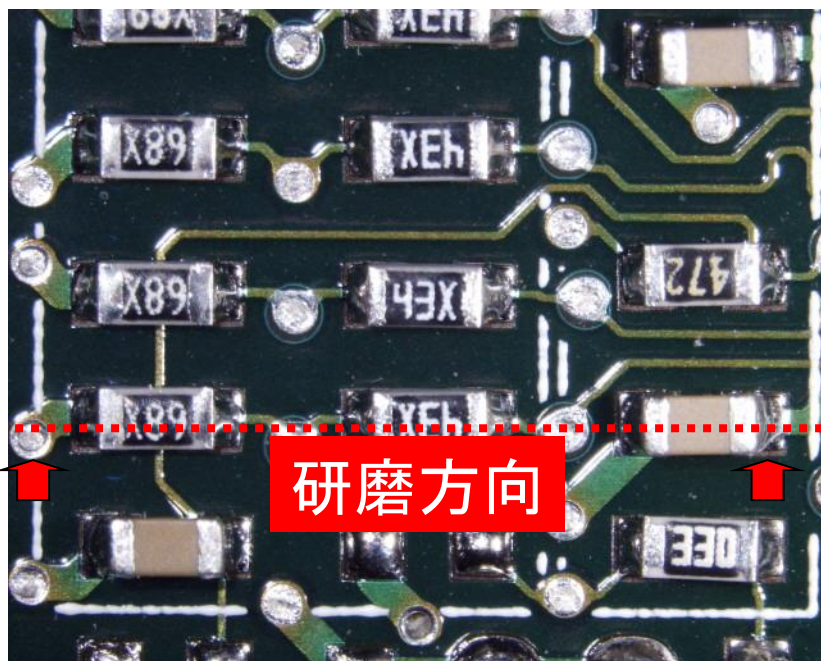


断面 全景写真

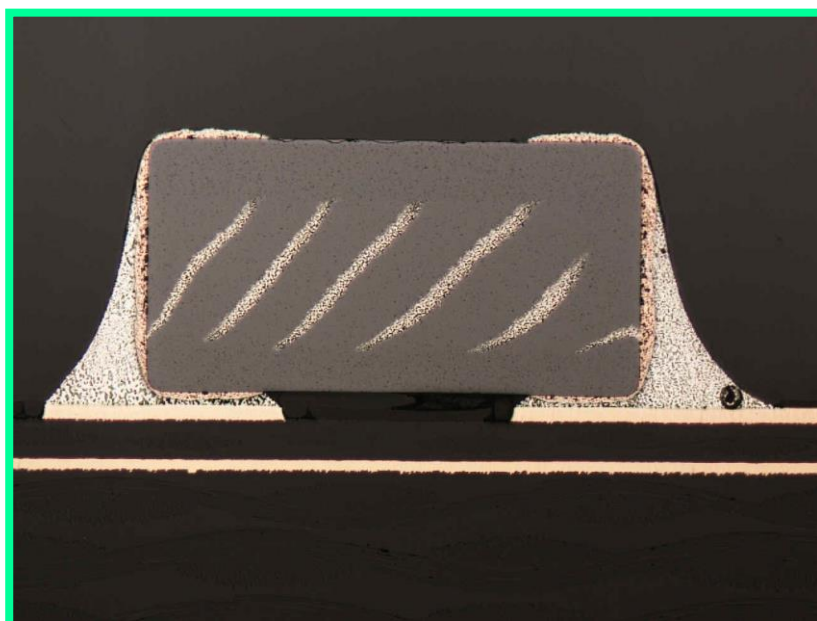


右側アウターリード 拡大

⑤a チップ部品(断面)

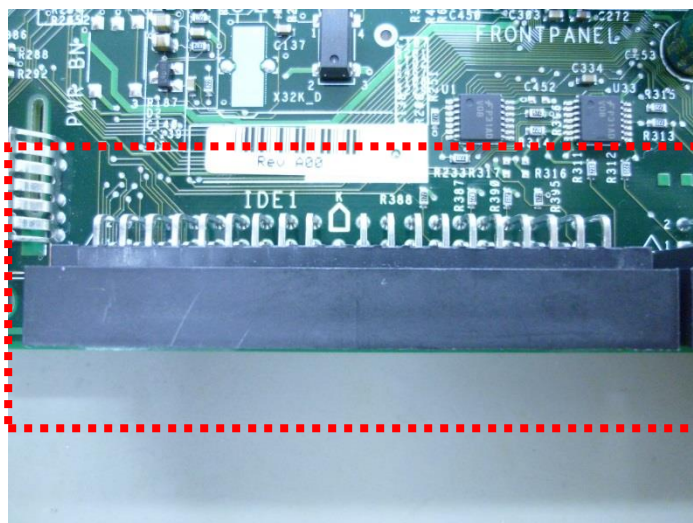


断面 全景写真

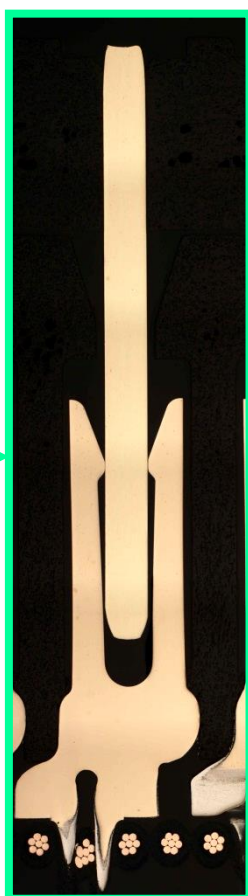


チップコンデンサ 拡大

⑥a コネクタ(平面: 勘合状態)

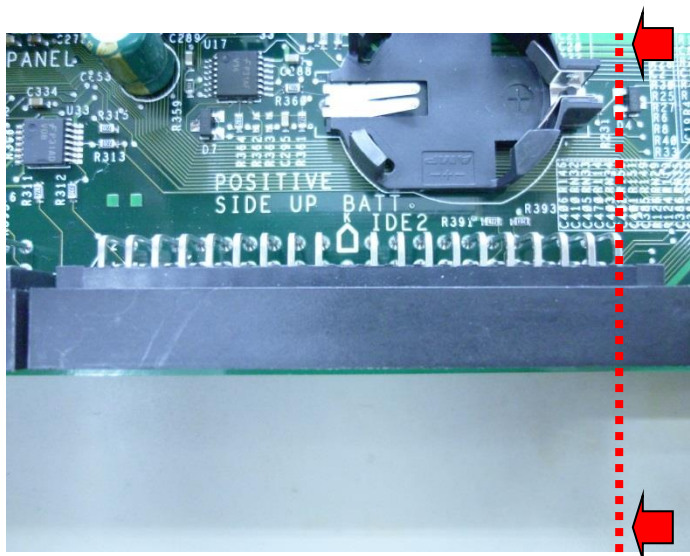


断面 全景写真

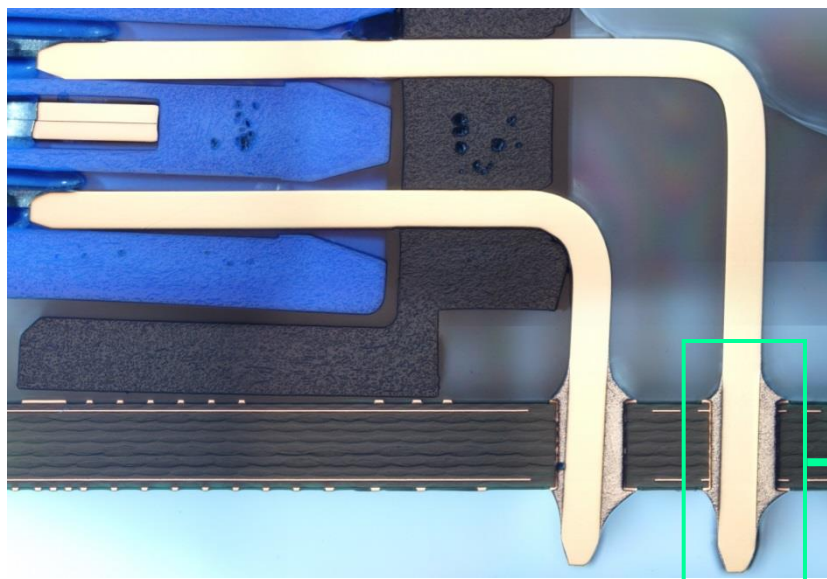


勘合部 拡大

⑥b コネクタ(断面)



研磨方向

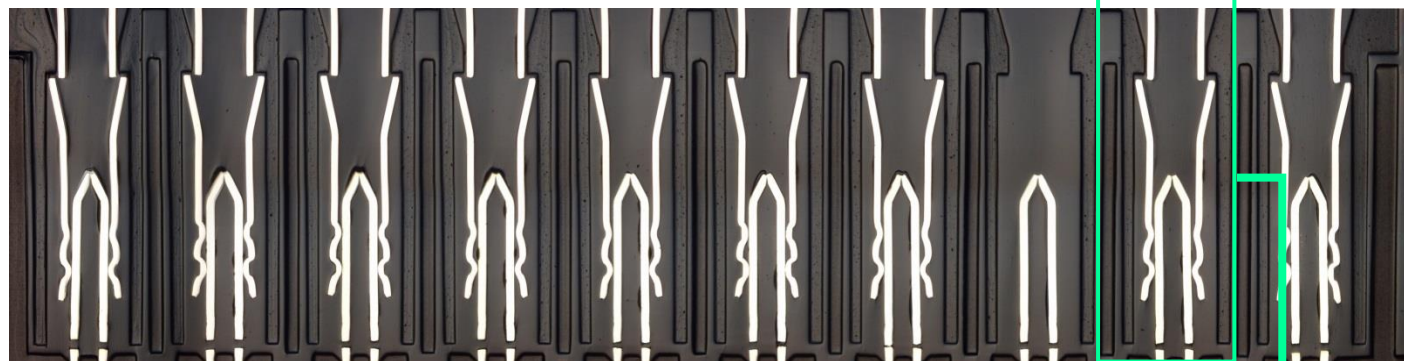
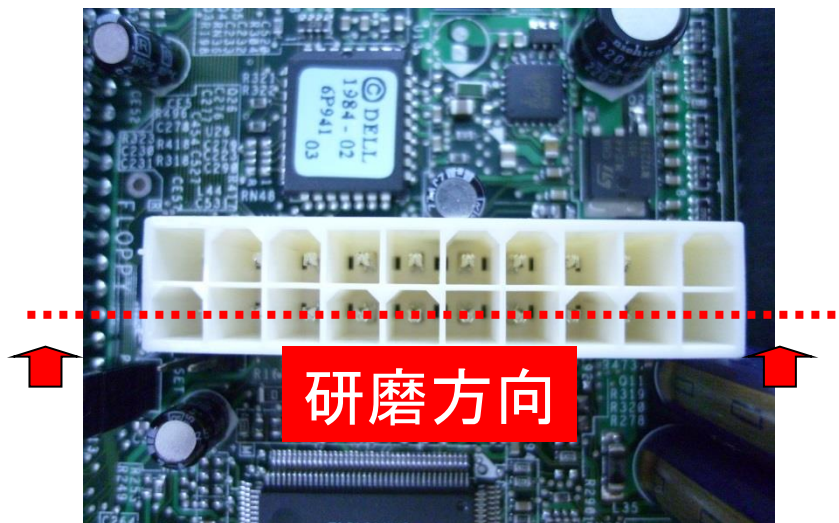


断面 全景写真

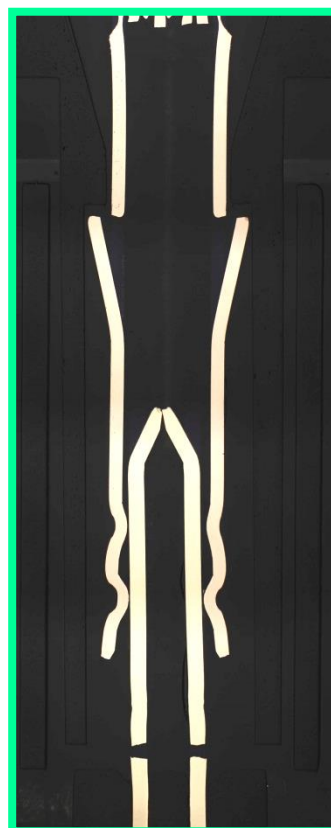


挿入実装部 拡大

⑥c コネクタ(断面)

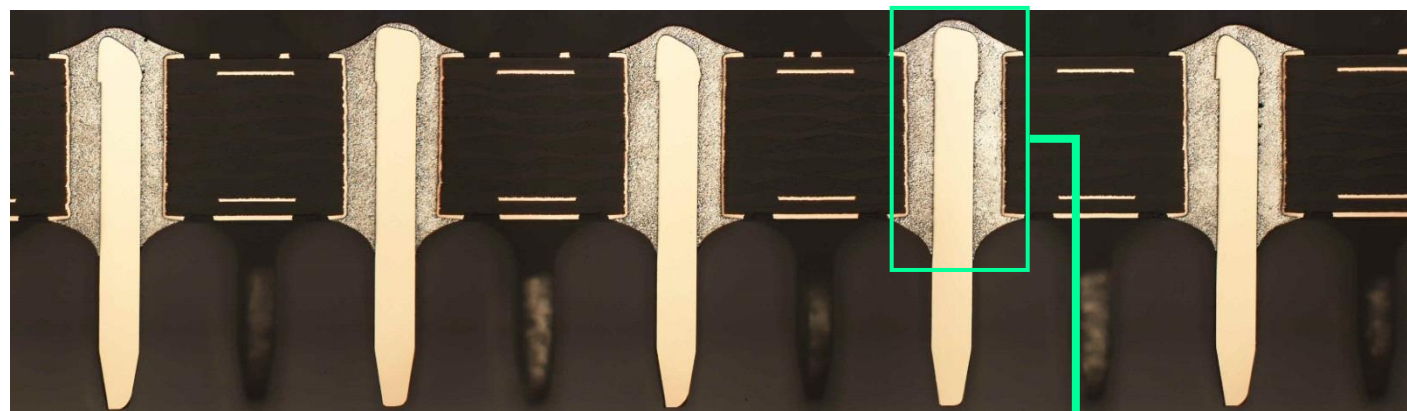
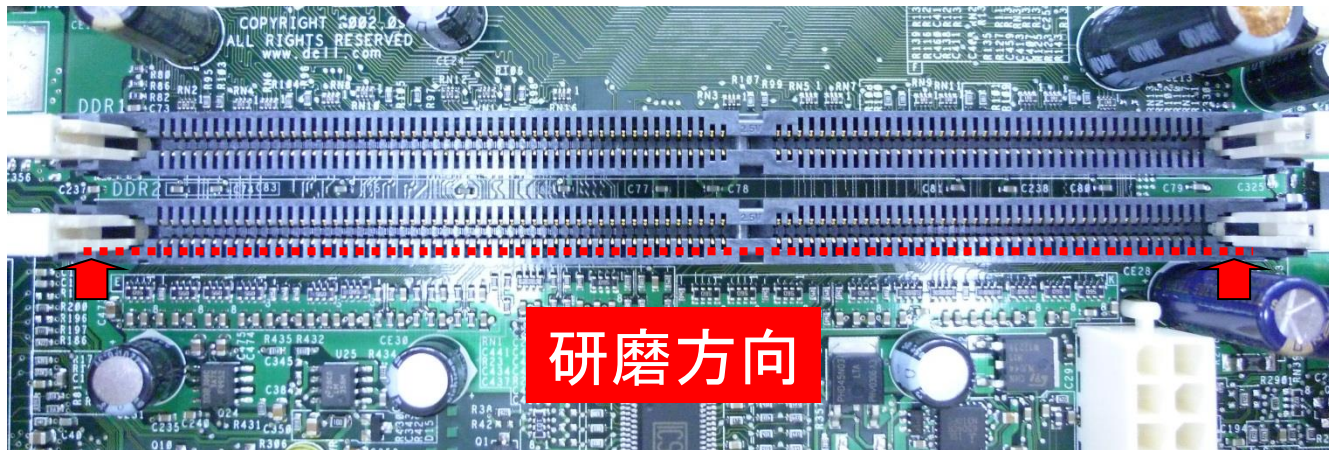


断面 全景写真



勘合部 拡大

⑦ コネクタ(断面)



断面 写真(5pin分)



挿入実装部 拡大